



### ■ 許容損失について (DFN(PLP)2020-8B)

DFN(PLP)2020-8Bパッケージの許容損失について特性例を示します。(DFN(PLP)1820-6パッケージのデータを代用)

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

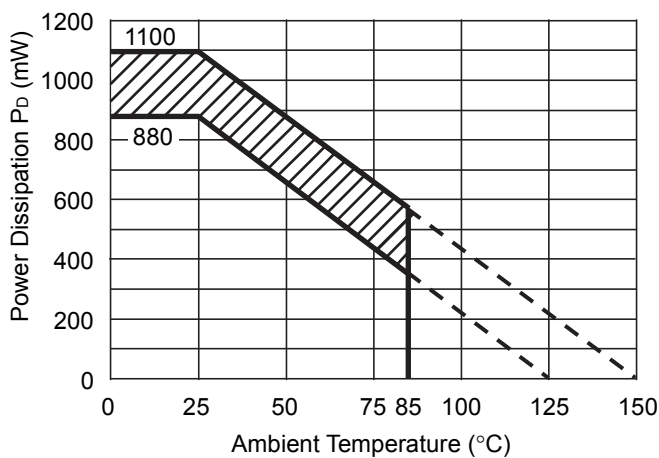
測定条件

標準実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%
スルーホール	直径 0.54mm × 30 個

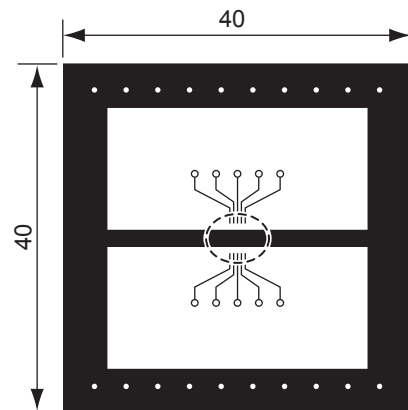
測定結果

(T<sub>opt</sub>=25°C, T<sub>jmax</sub>=125°C)

標準実装条件	
許容損失	880mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125 - 25^\circ\text{C}) / 0.88\text{W} = 114^\circ\text{C/W}$
	$\theta_{jc} = 22.8^\circ\text{C/W}$



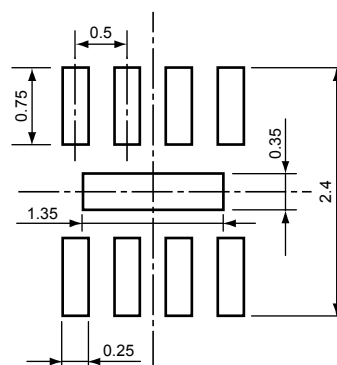
許容損失特性



測定用基板レイアウト

○ IC実装位置 (単位: mm)

### ■ 基板パッド推奨寸法 (DFN(PLP)2020-8B)



(単位: mm)